

平成 20 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名：住友金属鉱山株式会社
(コード：5713 東証第 1 部)
代表者名：代表取締役社長 家守 伸正
問合せ先：広報 IR 室 大場 浩正
(TEL：03 - 3436 - 7705)

住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社の吸収合併に関する 合併契約の締結について

当社は平成 20 年 11 月 1 日を期して、下記のとおり住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社を吸収合併することを決定し、同社と合併契約書を締結することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社では、コアビジネスの一つである電子材料および機能性材料事業の一層の拡大強化を図るため、本年 10 月 1 日をもって当該事業部門を『半導体材料事業部』および『機能性材料事業部』に再編することとしています。また、上記強化策の一環として、5 月には新製法による液晶パネル駆動用ドライバー用実装材料(COF)の増産について公表し、7 月には会社分割による結晶・磁性材料生産拠点の新会社設立について公表してきました。

これまで半導体用材料であるリードフレームおよび液晶パネル駆動用ドライバー実装材料 COF 用テープの製造・販売は、子会社である住友金属鉱山パッケージマテリアルズ(株)およびその傘下の子会社にて事業運営を行ってまいりました。10 月の組織改正に基づき、2 層めっき基板など他の半導体材料事業との連携性を高め、全社最適のシナジー効果を生み出すとともに、経営トップと密接な情報交換を行うことでスピーディかつ機動的な事業運営を行うことをめざして、11 月 1 日付けにて住友金属鉱山パッケージマテリアルズ(株)を吸収合併することとなりました。

なお、現在同社とお取引いただいているお客様につきましては、住友金属鉱山(株)半導体材料事業部が、引き続きお取引を継続させていただきます。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合 併 決 定 取 締 役 会	平成 20 年 8 月 8 日(金)
合 併 契 約 締 結	平成 20 年 8 月 8 日(金)
合 併 の 予 定 日 (効 力 発 生 日)	平成 20 年 11 月 1 日(土)(予定)

本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、住友金属鉱山パッケージマテリアルズ(株)においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会はいたしません。

(2) 合併方式

住友金属鉱山(株)を存続会社とする吸収合併方式で、住友金属鉱山パッケージマテリアルズ(株)は

解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株は当社の 100%子会社であるため株式を割り当てないことにしましたので該当ありません。

(4) 合併に係る割当ての内容の算定根拠等

株式を割り当てないため該当ありません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商 号	住友金属鉱山株式会社	住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社
(2) 事 業 内 容	非鉄金属鉱石の採掘、製錬業ならびに機能性材料および電子材料の製造業	半導体用リードフレームおよびC O F用テープの製造・販売 上記周辺および付帯事業
(3) 設 立 年 月 日	昭和25年3月1日	平成14年4月1日
(4) 本 店 所 在 地	東京都港区新橋5丁目11番3号	東京都立川市曙町2丁目38番5号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 家守 伸正	代表取締役社長 飯島 亨
(6) 資 本 金	93,242 百万円 (平成20年3月31日現在)	3,400 百万円 (平成20年3月31日現在)
(7) 発 行 済 株 式 数	581,628,031 株 (平成20年3月31日現在)	34,000 株 (平成20年3月31日現在)
(8) 純 資 産	640,345 百万円(連結) (平成20年3月31日現在)	78 百万円(単体) (平成20年3月31日現在)
(9) 総 資 産	1,091,716 百万円(連結) (平成20年3月31日現在)	9,575 百万円(単体) (平成20年3月31日現在)
(10) 決 算 期	3月31日	3月31日
(11) 従 業 員 数	9,786 名(連結)	39 名(単体)
(12) 主 要 取 引 先	住友商事(株) 三井物産(株) 住友電工(株)	Sumitomo Metal Mining Asia Pacific Pte. Ltd. NECグループ 三洋電機グループ
(13) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 9.98% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 9.55% 住友金属工業(株) 1.50% 資産管理サービス信託銀行(株)(信託Y口) 1.48% ビー・エヌ・ピー・パブリック・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッド(ビー・エヌ・ピー・パブリック証券会社) 1.33% (平成20年3月31日現在)	住友金属鉱山(株) 100% (平成20年3月31日現在)

(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 住友信託銀行(株)	(株)三井住友銀行 (株)三菱東京UFJ銀行
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	当社は被合併会社の株式100%を保有しております。
	人的関係	被合併会社の従業員は全員、当社からの出向社員であります。
	取引関係	被合併会社の借入金は全額当社からの貸付金であります。
	関連当事者への該当状況	被合併会社は住友金属鉱山の連結対象子会社であります。

(16) 最近3年間の業績

	住友金属鉱山株式会社 (完全親会社) (連結)			住友金属鉱山パッケージマテリアルズ 株式会社(完全子会社) (単体)		
決算期	H18年 3月期	H19年 3月期	H20年 3月期	H18年 3月期	H19年 3月期	H20年 3月期
売上高	625,579	966,764	1,132,372	12,334	15,212	12,003
営業利益	82,756	162,632	155,394	307	933	1,545
経常利益	99,716	205,285	217,866	372	1,024	1,860
当期純利益	62,800	126,054	137,808	435	1,007	2,222
1株当たり当期純利益(円)	109.96	220.49	238.13	21,752	29,633	65,377
1株当たり配当金(円)	14.00	27.00	30.00	-	-	-
1株当たり純資産(円)	654.15	859.82	1,017.96	95,442	67,686	2,309

(単位：百万円)

4. 合併後の状況

(1) 商号	住友金属鉱山株式会社
(2) 事業内容	非鉄金属鉱石の採掘、製錬業ならびに機能性材料および電子材料の製造業

(3)	本 店 所 在 地	東京都港区新橋 5 丁目 1 1 番 3 号
(4)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 家守 伸正
(5)	資 本 金	93,242 百万円
(6)	総 資 産	1,091,716 百万円 (連結)
(7)	純 資 産	640,345 百万円 (連結)
(8)	決 算 期	3 月 31 日

(9) 会計処理の概要

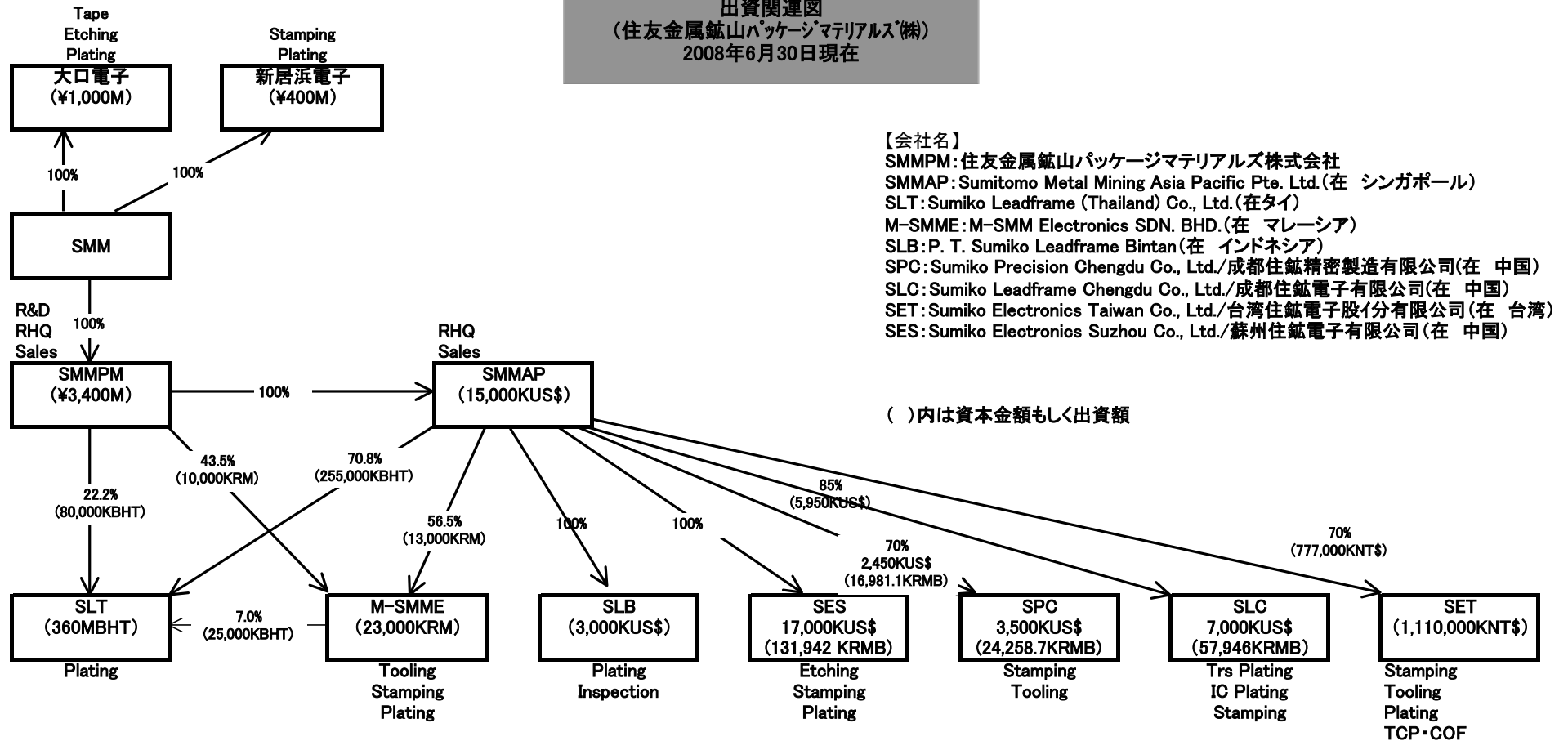
合併に伴う会計処理の変更はありません。

(10) 今後の見通し

合併による業績に与える影響は連結、単体とも軽微であります。

以 上

出資関連図
(住友金属鉱山パッケージマテリアルズ(株))
2008年6月30日現在



【事業展開】

リードフレーム事業及びCOFテープ事業は、SMMPMに加え、
上記海外の関係会社および大口電子・新居浜電子において運営されております。